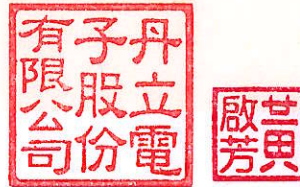


公司概況資料表

以下資料由丹立電子股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

- ✦ 認購相關資訊
- ✦ 公司簡介
- ✦ 主要業務項目
- ✦ 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
- ✦ 最近五年度簡明資產負債表
- ✦ 最近三年度財務比率



公司名稱：丹立電子股份有限公司 (股票代號：7866)

董事長	黃啟芳
總經理	詹鈞傑
資本額	386,712,130
輔導推薦證券商	華南永昌證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	華南永昌綜合證券股份有限公司羅仕宇先生 (02)2545-6888#8721
註冊地國	(不適用)
訴訟及非訟代理人	(不適用)

輔導推薦證券商認購丹立電子股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	華南永昌證券股份有限公司	第一金證券股份有限公司
認購日期	114/10/13	
認購股數 (股)	2,000,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	5.17%	0.27%
認購價格	30	
認購價格之訂定依據及方式	<p>本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之認購價格，作為丹立電子股份有限公司(以下簡稱丹立或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據；再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。</p>	

目前股票價值評估方法眾多，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，市價法為透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整，而常用的市價法有本益比法及股價淨值比法；成本法係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另收益基礎法之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

以上評估方法中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握；故本次輔導推薦證券商認購該公司股票，將就市場法之本益比法進行評估。

丹立電子股份有限公司主要從事記憶體產業的專業測試服務，業務涵蓋晶圓測試、IC 測試、模組測試及成品測試，並包含代工服務。經參考國內已上市櫃之同業資料，並無與該公司從事完全相同產品之同業，考量所經營業務及營運模式等條件後，彙總上市櫃公司中經營業務與該公司相似之同業，選取威剛科技股份有限公司(上櫃公司，股票代號3260，主要從事記憶體自有品牌公司，也是全球第二大記憶體模組廠。主要產品包括 DRAM 模組、SSD 固態硬碟、記憶卡、外接式硬碟等，並以自有品牌「ADATA」行銷全球)、十銓科技股份有限公司(上市公司，股票代號4967，主要以自有品牌 TEAMGROUP 行銷全球，產品包括記憶體模組、SSD 與電競週邊。結合 ODM 代工與品牌銷售，並在消費性與工控市場皆有布局)、群聯電子股份有限公司(上櫃公司，股票代號8299，主要從事 NAND FLASH 控制 IC 及周邊系統產品的研發設計製造及銷售。公司已經成為 USB 隨身碟、SD 記憶卡、eMMC、UFS、PATA、SATA 與 PCIe 固態磁碟等控制晶片領域的領頭廠)做為採樣公司，其最近三個月之本益比法之訂價依據分述如下：

採樣同業、上市(櫃)半導體類股於114年6月至8月本益比如下：

單位：倍

公司	月份	114年6月	114年7月	114年8月	最近三個月平均
威剛(3260)		14.31	13.88	13.94	14.04
十銓(4967)		19.44	19.00	26.60	21.68
群聯(8299)		16.09	15.50	18.54	16.71
上市-半導體類		21.22	23.06	21.33	21.87
上櫃-半導體類		28.66	28.82	35.15	30.88

資料來源：臺灣證券交易所(下稱證交所)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下

稱櫃買中心)

由上表得知，該公司採樣同業、上櫃半導體類股及上市半導體類股最近三個月(114年6月~114年8月)平均本益比區間為14.04~30.88倍，經參閱丹立電子(股)公司113年度經會計師查核簽證之財務報告歸屬於該公司之稅後淨利為32,978千元，每股盈餘1.32元，並依上表同業之平均本益比區間估算，該公司之合理每股參考價區間為18.53~40.76元，經考量興櫃市場交易流動性風險，以八折設算後之參考價格區間為14.82~32.61元。本輔導證券商與該公司議定興櫃主辦及協辦輔導證券商之每股認購價格為30元，介於每股參考股價區間之內。

綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定係參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並參考該公司之所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，故本推薦券商與該公司共同議定興櫃主辦及協辦輔導證券商之認購價格為每股30元，介於合理價格區間內，認購價格尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

丹立成立於民國100年，總部位於新北市中和區，專注於記憶體產業的專業測試服務，業務涵蓋晶圓測試、IC 測試、模組測試及成品測試，並包含代工服務。近年來，該公司新增 DRAM 模組、SSD 固態硬碟及顯示卡等成品的研發與銷售業務，並致力於提供一站式產品解決方案，滿足客戶從元件到成品的多元需求。

未來丹立將以記憶體專業為基礎，延伸布局 AI 邊緣運算應用場景，結合在高速記憶體與儲存裝置的核心技術優勢，正式跨足 AI Edge 伺服器之設計、組裝、測試與量產服務(ODM/EMS)，提供高效能 GPU 伺服器平台，滿足智慧製造、工業視覺、安防監控等邊緣 AI 應用需求。

此外，丹立同步發展 AI 模型微調訓練與推論應用整合平台，導入 LoRA、ONNX、TensorRT 等新世代 AI 模型部署技術，實現從資料前處理、模型優化、部署導出到邊緣推論的完整技術鏈，結合伺服器硬體整合與 AI 模型優化能力，創造軟硬體一體的差異化服務。

透過技術與業務的雙軌轉型，丹立正從零組件測試走向 AI 整合平台，打造全方位 AIoT 解決方案夥伴，攜手客戶共同迎向智慧化、邊緣化與高效化的產業新世代。

二、公司沿革

年度	重要事蹟
100年	<ul style="list-style-type: none">• 丹利電子有限公司核准設立，實收資本額新臺幣500萬元。• 主要提供專業測試解決方案的服務。
101年	<ul style="list-style-type: none">• DRAM MOUDLE 通過海外客戶品質認證。(ISO 或其他具體認證項目?)
103年	<ul style="list-style-type: none">• SSD 產線進入測試。
105年	<ul style="list-style-type: none">• 組織變更為股份有限公司。• 辦理現金增資新台幣500萬元，增資後實收資本額為新台幣10,000仟元。• 通過海外客戶高階產品測試品質認證。

106年	<ul style="list-style-type: none"> • 通過 ISO9001 認證。 • 辦理現金增資新台幣20,000仟元，增資後實收資本額為新台幣30,000仟元。 • 辦理現金增資新台幣90,000仟元，增資後實收資本額為新台幣120,000仟元。 • 辦理現金增資新台幣80,000仟元，增資後實收資本額為新台幣200,000仟元。
107年	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理現金增資新台幣100,000仟元，增資後實收資本額為新台幣300,000仟元。
109年	<ul style="list-style-type: none"> • 導入產品自動化生產線。 • 推出 DDR4 標準 U-DIMM / SO-DIMM 32GB 大容量記憶體模組。 • 開發 LPDDR3、LPDDR4/4X 記憶體測試設備與驗證工具，並建立完整測試服務流程，強化對行動裝置記憶體產品之品質控管與驗證能力。 • 推出具 RGB 發光功能之 DDR4 OC 電競記憶體模組，提升品牌於消費性電競市場之辨識度與競爭力。 • 發表首款 PCIe Gen3 M.2 SSD，專為高效能筆電與桌上型電腦市場設計，實現高效資料存取與系統反應速度。 • 辦理現金增資新台幣100,000仟元，增資後實收資本額為新台幣400,000仟元。
110年	<ul style="list-style-type: none"> • 推出 DDR5 桌上型電腦專用記憶體模組，領先業界導入次世代高頻寬記憶體產品。 • 發表 DDR4 R-DIMM 與工業級 DDR4 ECC DIMM / SO-DIMM，強化伺服器與嵌入式系統市場佈局。 • 開發 PCIe Gen4 x4 SSD(M.2 2280 規格)，鎖定高速儲存市場與次世代平台需求。
111年	<ul style="list-style-type: none"> • DLI 品牌成立，期許成為全方位的世界級測試廠。 • 推出 DDR5 筆記型電腦專用記憶體模組，支援高效能行動平台與新世代筆電架構。 • 發表 DDR5 OC RGB 高速記憶體產品，提供 6000 / 6400 MT/s 頻率選擇，滿足電競玩家與創作者市場。 • 推出 DDR5 RDIMM 模組，支援伺服器與高運算平台對大容量與穩定性的需求。 • 發表單面設計之 PCIe Gen4 x4 SSD，專為筆電空間優化與效能兼顧需求打造，支援 512GB / 1TB / 2TB 容量。
112年	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理現金減資新台幣93,941仟元，減資後實收資本額為新台幣306,060元。 • 推出專為小型工作站設計的超頻型 DDR5 OC R-DIMM，兼具伺服器穩定性與高效能特性。 • 發表 DDR5 高時脈產品，推出 7800MHz CL38 高規格記憶體模組，強化極限超頻市場佈局。 • 推出 DDR5 標準型 U-DIMM / SO-DIMM 32GB 大容量模組與 5600MHz 主流頻率產品，滿足各類平台升級需求。 • 推出符合 V30、UHS-I U3、A2 等級之高速記憶卡產品，支援高效能 Android 裝置與影像錄製需求。

	<ul style="list-style-type: none"> • 發表 4TB 大容量 PCIe Gen4 x4 消費型 SSD，提供高速與儲存空間兼具之解決方案。 • 首次推出支援 QLC 架構之 SSD，針對大容量需求市場提供具成本效益的儲存方案。 • 開發 LPDDR4 / 4X 系統等級測試平台，並提供針對 SoC 整合與長時間穩定性之測試服務。
113年	<ul style="list-style-type: none"> • 公司更名為「丹立電子股份有限公司」。 • 辦理現金減資新台幣91,509仟元，減資後實收資本額為新台幣214,551仟元。 • 辦理現金增資新台幣85,449仟元，增資後實收資本額為新台幣300,000仟元。 • 發表 DDR5 標準 U-DIMM 24GB / 48GB 中大容量模組，拓展桌機與工作站彈性擴充解決方案。 • 建立 LPDDR5 系統等級測試平台與驗證服務，強化行動與嵌入式記憶體整合驗證能力。 • 推出 DDR5 6000 CL30 與 6400 CL32 低延遲高效能記憶體模組，精準對應遊戲、創作與多工場景需求。 • 推出 DDR5 ECC SO-DIMM / ECC U-DIMM 工業級模組，專為工控系統與嵌入式裝置提供高穩定性記憶體方案。
114年	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理現金增資新台幣60,000仟元，增資後實收資本額為新台幣360,000仟元。 • 辦理盈餘轉增資新台幣26,712仟元，增資後實收資本額為新台幣386,712仟元。 • 向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃股票櫃檯買賣併送申報辦理股票簡易公開發行。

三、經營理念

本公司自成立以來，秉持誠信的經營原則，專注於本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理，提升管理品質及績效，並保持和諧之勞資關係，以維持優良企業形象。

四、未來展望

(1) 短期發展計畫

A. 記憶體業務強化

持續擴充晶圓測試、IC 測試、模組測試與成品測試產能，導入自動化測試系統以提升良率與效率；深化與記憶體品牌商及 IC 設計公司的代工合作，提供更多客製化測試服務(含 Burn-in、選別測試等)強化 DRAM 模組、SSD 與顯示卡自有產品開發與通路銷售佈局，提高該項產品營收占比。

B. AI Edge 伺服器初步布局

(a) 建置 Edge 伺服器樣機(EVT、DVT 階段)，完成2款標準機種(如 EdgeForge-H2X 與 H4X)開發；

(b) 建立組裝與系統測試流程(GPU 燒機、功耗、散熱、連接測試)與產線整合；

(c)啟動 AI 模型微調與推論平台(EdgeForge AI Suite)MVP 版本開發，完成基本微調導入與模型推論測試；

(d)與既有 B2B 記憶體客戶合作進行第一階段 PoC(智慧工廠、邊緣影像應用)驗證。

(2) 中長期發展計畫

A. 記憶體產業升級與平台化

將測試業務平台化、數位化，發展以雲端介面提供即時測試回報與數據分析服務導入 AI 品管系統(AI for QC)進行產線異常預測與良率分析，進一步降低 RMA 成本拓展高端模組(DDR5、HMB、工控用 DRAM)、企業級 SSD 產品線，切入 AI/伺服器儲存應用市場。

B. AI Edge 業務擴大與產品服務化

(a)建立完整 Edge 伺服器產品線(含4GPU 高階版本)，支援多種 GPU 配置與客製化應用模組(如 AOI、人臉分析)；

(b)完成 AI Suite 商業化版本，支援 LoRA 微調、多模型同平台推論、IoT 邊緣導出(ONNX、TFLite、Mali GPU)；

(c)推出 Edge AI 整合服務方案(硬體+AI 平台+應用)，導入至智慧製造、智慧城市、邊緣安防等領域；

(d)探索 SaaS 模式，將 AI 推論與訓練功能包裝為模組化服務，搭配 Edge 伺服器設備銷售提升每用戶平均收入(ARPU)。

綜上，本公司將以記憶體測試技術為基礎，逐步整合 AI 伺服器硬體與軟體平台能力，從元件驗證服務商轉型為「AI Edge Solution Provider」，提供從硬體製造、AI 模型訓練、到終端應用落地的全方位解決方案。

主要業務項目：	
主要產品(服務)	產品(服務)用途
記憶體模組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 記憶體模組廣泛適用於桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、工作站、工業電腦、印表機等多元裝置平台，亦涵蓋電競與超頻應用場景，並支援 RGB 發光與非發光等多樣外觀設計，以滿足消費性市場與專業應用之多元需求。 2. 針對各類特殊應用環境與客戶差異化需求，提供靈活多樣的記憶體模組客製化解決方案，包含產品規格調整、環境耐受設計、相容性驗證及長期供貨支持，協助系統整合商實現最佳化配置與效能。 3. 具備完整支援 DDR3、DDR3L、DDR4 與 DDR5 等主流標準之 DRAM 記憶體晶片，涵蓋多種傳輸速度、容量與封裝規格，廣泛應用於記憶體模組製造及各類系統平台之整合設計，確保高度相容性與穩定性。
快閃記憶體應用產品	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供多款符合業界標準之商用型 SD 記憶卡，並延伸至高階專業用 SD 卡與次世代 CFexpress 記憶卡產品，全面支援從一般消費性應用至需高傳輸速率與穩定性的專業影像處理、4K/8K 攝影及高速連拍等嚴苛工作負載需求。 2. 推出具備 USB 3.2 及 USB 2.0 介面的高效能隨身碟產品，提供高速資料傳輸能力與廣泛平台相容性，適用於日常儲存、商務資料攜帶、教育用途與行動辦公等多種應用場景，兼具穩定性與便利性。 3. 針對通用型設備與垂直應用市場，開發兼具高穩定性與靈活彈性之 Micro SD 記憶卡產品，廣泛應用於智慧型手機、行車紀錄器、車載資訊娛樂系統、安防監控設備與 IoT 裝置等多元終端，滿足嚴格操作環境下的長時運作與可靠性需求。
固態硬碟	<p>提供涵蓋多元儲存介面規格之固態硬碟 (SSD) 產品組合，支援 SATA III、PCIe Gen3/Gen4 等主流傳輸介面，滿足從日常使用到專業應用等多樣化情境需求。產品線包括針對電競玩家與數位內容創作者設計之高效能型與功能導向型 SSD，具備高速讀寫、穩定效能與散熱優化特性；同時亦提供適用於嵌入式系統、工控裝置與車載設備等特殊應用市場之工業等級 SSD，涵蓋 2.5 吋 SATA、M.2 (SATA/NVMe) 及 PCIe 擴充卡等多種封裝與介面選擇，強調可靠性、耐久性與長期供應穩定性。</p>
低功耗記憶體	<p>提供完整世代之行動裝置專用低功耗記憶體 (LPDDR) 產品組合，涵蓋 LPDDR3、LPDDR4、LPDDR4X 至最新一代 LPDDR5 規格，具備高頻寬、低延遲與超低功耗等關鍵技術特性。產品廣泛應用於智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置等消費性電子產品，亦支援車用電子、工業控制、邊緣運算及 AIoT 等嵌入式系統平台，有效提升系統效能與能源效率，滿足高速運算與長效續航之雙重需求。</p>
測試服務	<p>提供涵蓋記憶體與快閃儲存產品之全方位測試與驗證服務，測試範疇涵蓋元件級 (Component Level)、模組級 (Module Level) 至系統級 (System Level)，確保產品在多元應用環境下具備卓越的穩定性、相</p>

	容性與長期可靠性。服務項目包括功能驗證、相容性測試、環境壓力測試（如高低溫、溫循）、訊號完整性分析（SI/PI）、長時間壽命測試（Burn-in）、韌體驗證與客戶端平台認證，協助客戶加速產品導入流程並提升整體品質水準。
客製化專案新產品開發服務	針對不同客戶的應用需求與市場定位，提供量身打造之專屬解決方案，涵蓋記憶體模組、快閃儲存裝置及嵌入式系統設計。透過深度了解客戶產品特性與使用情境，整合高速記憶體、耐久型儲存介面與多樣封裝技術，實現最佳化的系統效能、可靠性與成本效益，協助客戶在競爭激烈的市場中建立差異化優勢。
記憶體模組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全新開發之 DDR5 CUDIMM 與 CSODIMM 記憶體模組，採用非緩衝架構並支援 Command/Address parity 功能，進一步提升資料傳輸過程中的錯誤檢測能力與系統穩定性。結合高頻寬、高效能與長時間運作穩定性，特別針對嵌入式系統、準伺服器型筆記型電腦、工業電腦與邊緣運算裝置等應用場景設計，為對可靠性與記憶體完整性要求嚴苛的系統平台提供最佳化解決方案。 2. 因應新世代筆記型電腦與電競筆電對記憶體模組在性能與節能間的高度要求，推出全新 LPCAMM2 記憶體模組。產品採用低功耗架構設計，並整合高密度封裝技術，在有限空間內提供更佳頻寬效能表現，同時降低功耗與發熱量。此模組具備輕薄化、可擴充與高效能三大特點，為高階筆電與行動運算裝置提供次世代記憶體解決方案。 3. 為滿足高階遊戲玩家與專業超頻用戶對極致效能的需求，推出新一代 DDR5 高速超頻記憶體模組，支援運行頻率自 DDR5-6000 至 DDR5-8000MHz 以上，並提供多元容量選項，包括 32GB、48GB 與 64GB 單條配置。此系列產品兼具高頻寬、高容量與低延遲特性，搭配散熱優化設計與發光 RGB 模組選配，為電競平台與創作者主機打造卓越效能體驗。
快閃記憶體應用產品	<ol style="list-style-type: none"> 1. 積極拓展高速大容量記憶卡產品組合，推出具備高速讀寫效能與大容量儲存能力之產品，專為 4K/8K 高解析錄影、高速連拍、資料密集型處理等應用情境設計，廣泛適用於智慧型行動裝置、專業攝錄設備、無人機以及工業級資料擷取與儲存裝置，滿足高效能儲存市場之多樣需求。 2. 導入符合 Application Performance Class A1 / A2 標準之新一代記憶卡，專為行動應用程式運行效能最佳化設計，顯著提升隨機讀寫能力，有效加快 Android 系統中 APP 啟動、資料讀取與多工處理效率，亦適用於嵌入式平台與 IoT 裝置，提升整體系統操作流暢度與使用體驗。 3. 全新推出支援 UHS-II 高速介面之記憶卡，採用雙排接點設計，資料傳輸速度較 UHS-I 大幅提升，可達最高 312MB/s，專為專業級攝影、RAW 格式連拍、高幀率錄影與高速影像擷取等應用場景打造，確保資料寫入即時且穩定，滿足高階影像處理與多媒體內容創作需

	<p>求。</p> <p>4. 開發符合 SD Express 標準之記憶卡產品，結合 SD 界面與 PCIe / NVMe 傳輸技術，提供媲美 SSD 的超高速效能與低延遲表現，資料傳輸速度最高可達 985MB/s，適用於 AIoT、邊緣運算、工業控制系統及嵌入式平台，為需要高速資料處理的次世代應用場景提供高效儲存解決方案。</p> <p>5. 全面升級 USB 隨身碟產品線，採用 USB 3.2 Gen 1 / Gen 2 傳輸介面，最高支援 10Gbps 高速資料傳輸，適用於大容量資料備份、影音檔案儲存與高速傳輸需求。以 USB Type-C 為主打介面設計，具備更佳相容性與攜帶便利性，支援多平台使用環境，適合行動辦公、教育、創作與商業應用等多元情境。</p>
固態硬碟	<p>1. 最新一代 PCIe Gen5 SSD 採用 PCIe 5.0 高速傳輸介面，相較前一代 PCIe 4.0 提供高達兩倍的傳輸頻寬，理論讀寫速度可達 14 至 16 GB/s，為高效能運算（HPC）、AI 模型訓練、資料中心及次世代伺服器平台提供突破性儲存效能。該產品專為滿足高速資料吞吐、低延遲處理與多工任務並行運作而設計，有效支援關鍵任務與密集型運算環境中之高速資料流動需求。</p> <p>2. 推出支援 2.5 吋 SATA III、M.2 SATA、M.2 PCIe（NVMe）以及外接式介面等多種規格之高容量 SSD 產品，提供靈活儲存配置以因應不同平台應用需求。此系列 SSD 兼具大容量儲存空間、穩定持續效能與廣泛系統相容性，廣泛適用於筆記型電腦、桌上型電腦、工業控制系統與嵌入式設備，特別適合需長時間運作與資料安全保障的場景，提供高可用性與整合彈性。</p>
低功耗記憶體	<p>LPDDR5X 為新一代低功耗記憶體標準，基於 LPDDR5 架構進一步優化設計，顯著提升資料傳輸效能與能源效率。該標準支援最高傳輸速率達 8533 Mbps，相較前代擁有更高頻寬表現，同時強化功耗控制機制，降低系統整體能耗。LPDDR5X 特別適用於高效能行動裝置、AIoT 應用、5G 通訊終端、車用電子及邊緣運算平台，為需高速、低延遲與低功耗之嵌入式系統提供卓越記憶體解決方案。</p>
AI Edge Server	<p>AI 模型部署平台</p> <p>簡化 AI 模型在伺服器基礎設施上的部署、管理和擴展，提供直觀的使用者介面和自動化工具，讓客戶能夠輕鬆管理其 AI 工作負載。</p> <p>MLOps 工作流程編排工具</p> <p>自動化和端到端機器學習生命週期，包括資料準備、模型訓練和部署，提高 AI 開發團隊的效率和生產力。</p> <p>AI 伺服器監控與管理軟體</p> <p>與伺服器硬體深度整合的工具，進行效能監控、資源優化和預測性維護，確保系統穩定運行並最大化硬體投資回報。</p>

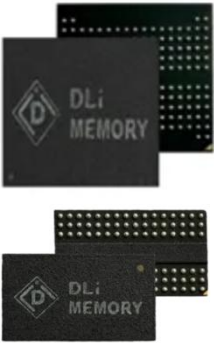
	<p>AI 安全軟體</p> <p>專為 AI 伺服器環境設計的安全解決方案，包括威脅偵測和資料保護，保障客戶的 AI 資產和敏感數據安全。</p>
AI 工廠智慧化服務	<p>AI 安全監控與安防</p> <p>影像辨識能實時監測可疑行為或人員異常行為，顯著提高整體安全性並增強防範能力。</p> <p>AI 異常偵測監控</p> <p>自動識別和分類零組件，提高生產效率和品質，即時異常回報。瑕疵檢測，即時降低人為錯誤。生產線效率分析，即時統計與分析異常狀況，追蹤異常發生區間與原因。</p> <p>AI 製程優化</p> <p>分析歷史生產數據、訂單資訊、設備狀態等因素，自動生成最佳生產排程方案，縮短生產週期並提高設備利用率。自動生成生產參數，如原物料配比，生產效率預估，各站效率預測等，使作業流程更加精細靈活。</p> <p>AI 預測性維護</p> <p>預測機器維護週期，將正常運行時間最大化並提升整體設備效能，提高勞動生產力。預防設備故障和停機時間，延長重要資產的整體壽命期。主動規劃安排維護，提高生產設備負載轉移效率。</p>
HBM 測試服務	<p>HBM3 KGDs 模組的測試與分析。</p> <p>部份不良位置修復，提高 HBM KGDs 模組的良率。</p>

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

本公司屬於記憶體產業中游之專業測試廠商，提供記憶體產業專業測試服務，包括晶圓、IC、模組測試，涵蓋委託製造服務。此外，公司開始擴展至 AI 邊緣運算應用，結合伺服器與 AI 模型優化能力，創造差異化的軟硬體整合服務。本公司具備自主撰寫程式及程式優化之能力，並輔以代工及組包服務。茲將產業之上、中、下游之關聯性概略圖示如下：



產品名稱	產品圖示 及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
記憶體產品	<p>Gaming</p>  <p>Desktop & Laptop</p>  <p>Server</p> 	<p>本公司提供完整支援 DDR3、DDR3L、DDR4與 DDR5等主流標準之 DRAM 記憶體晶片，廣泛適用於桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、工作站、工業電腦、印表機等多元裝置平台，亦涵蓋電競與超頻應用場景，並支援 RGB 發光與非發光等多樣外觀設計，以滿足消費性市場與專業應用之多元需求。</p>	874,503	77.99
快閃記憶體	<p>Memory Card</p>  <p>USB Flash Drives</p> 	<p>本公司提供多款符合業界標準之商用型 SD 記憶卡，並延伸至高階專業用 SD 卡與次世代 CFexpress 記憶卡產品，全面支援從一般消費性應用至需高傳輸速率與穩定性的專業影像處理、4K/8K 攝影及高速連拍等嚴苛工作負載需求。</p> <p>本公司亦提供多款具備 USB 2.0~USB 3.2介面的高效能隨身碟產品，提供高速資料傳輸能力與廣泛平台相容性，適用於日常儲存、商務資料攜帶、教育用途與行動辦公等多種需求。</p>	115,027	10.26
工控產品	<p>SSD</p>   <p>低功耗記憶體</p>	<p>本公司提供涵蓋多元儲存介面規格之固態硬碟(SSD)產品組合，支援 SATA III、PCIe Gen3/Gen4等主流傳輸介面，滿足從日常使用到專業應用等多樣化情境需求。產品線包括針對電競玩家與數位內容創作者設計之高效能型與功能導向型 SSD，具備高速讀寫、穩定效能與散熱優化特性；同時亦適用於嵌入式系統、工控裝置與車載設備等特殊應用市場之工業等級 SSD。</p>	53,847	4.80

		<p>本公司提供完整世代之行動裝置專用低功耗記憶體 (LPDDR) 產品組合，涵蓋 LPDDR3、LPDDR4、LPDDR4X 至最新一代 LPDDR5 規格，具備高頻寬、低延遲與超低功耗等關鍵技術特性。產品廣泛應用於智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置等消費性電子產品，亦支援車用電子、工業控制、邊緣運算及 AIoT 等嵌入式系統平台。</p>		
其他(註)	測試服務	<p>本公司提供涵蓋記憶體與快閃儲存產品之全方位測試與驗證服務，測試範疇涵蓋元件級(Component Level)、模組級(Module Level)至系統級(System Level)，確保產品在多元應用環境下具備卓越的穩定性、相容性與長期可靠性。項目包括功能驗證、相容性測試、環境壓力測試(如高低溫、溫循)、訊號完整性分析(SI/PI)、長時間壽命測試(Burn-in)、韌體驗證與客戶端平台認證，協助客戶加速產品導入流程並提升整體品質水準。</p>	77,877	6.95
合 計			1,121,254	100.00

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	112年 (註1)	113年 (註1)	114年截至 8月份止(註2)
營業收入		166,701	206,004	298,741	971,078	1,121,254	2,225,178
營業毛利		21,146	3,143	(24,532)	1,308	90,250	136,325
毛利率(%)		12.69	1.53	(8.21)	0.13	8.05	6.13
營業損益		(20,906)	(31,783)	(50,496)	(51,228)	25,433	78,071
營業外收入		3,989	1,359	18,210	2,564	11,665	46,988
營業外支出		(11,885)	(6,106)	(1,038)	(53,248)	(5,136)	(84,621)
稅前損益		(28,802)	(36,530)	(33,324)	(101,912)	31,962	40,437
稅後損益		(27,873)	(37,756)	(34,722)	(91,508)	32,978	40,437
每股盈餘(元)		(0.70)	(0.94)	(0.87)	(4.27)	1.32	1.05
發放	現金股利(元)	(30,782)	-	-	-	-	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-

TOP ^

註1：係依照國際財務報導準則編製個別財務報告，上述財務報告皆經會計師查核簽證。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

註3：本公司並無子公司，故未編制合併財務報告。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	112年 (註1)	113年 (註1)
項目						
流動資產		235,604	172,966	191,503	299,790	586,221
基金及長期投資		-	-	-	-	-
固定資產		256,985	256,820	220,160	128,435	102,949
無形資產		4,726	5,437	3,654	2,361	1,147
其他資產		15,360	6,849	9,763	19,254	42,808
資產總額		512,675	442,072	425,080	449,840	733,125
流動負債	分配前	95,661	85,395	112,416	204,540	335,064
	分配後	95,661	85,395	112,416	204,540	335,064
長期負債		31,219	13,761	1,074	24,685	39,078
其他負債		7,258	2,135	5,531	6,064	24,563
負債總額	分配前	134,138	101,291	119,021	235,289	398,705
	分配後	134,138	101,291	119,021	235,289	398,705
股本		400,000	400,000	400,000	306,060	300,000
待分配股票股利		-	-	-	-	-
資本公積		-	-	-	-	1,442
保留盈餘	分配前	(21,463)	(59,219)	(93,941)	(91,509)	32,978
	分配後	(21,463)	(59,219)	(93,941)	(91,509)	32,978
長期股權投資 未實現跌價損失		-	-	-	-	-
累積換算調整數		-	-	-	-	-
股東權益總額	分配前	378,537	340,781	306,059	214,551	334,420
	分配後	378,537	340,781	306,059	214,551	334,420

TOP ^

註1：係依照國際財務報導準則編製個別財務報告，上述財務報告皆經會計師查核簽證。

註2：本公司並無子公司，故未編制合併財務報告。

最近三年度財務比率

年度		111年	112年	113年
項目				
財務比率	毛利率(%)	(8.21)	0.13	8.05
	流動比率(%)	170.35	146.57	174.96
	應收帳款天數(天)	76	33	42
	存貨週轉天數(天)	38	23	70
	負債比率(%)	28.00	52.31	54.38

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)